



# tesa® 70665 Bond & Detach

## 제품 정보

650µm Bond & Detach 양면 블랙 접착&분리 테이프

## 제품 설명

tesa® 70665 제품은 양면 블랙 마운팅 테이프로, 접착제를 눌러 쉽게 제거할 수 있습니다.

## 특성

- Thickness: 650µm
- Light blocking
- Very high bonding strength
- Superior push out and shock resistance
- Easy removability even after long bonding time

## Applications

- Battery mounting
- \* Permanent mounting of components in electronic devices with the option to remove the parts for repairing or recycling
- \* Temporary fixation of components
- \* Light blocking in displays and mobile phone applications

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

• 기재 소재	없음	• 컬러	검정
• 접착제 종류	특수	• 이형지 두께	72 µm
• 이형지 종류	글라신지	• 이형지 색깔	갈색
• 총두께	650 µm		

## 속성 / 성능 값

• 14일 경과 제거성 (23°C)	very good	• 장기간 온도저항	60 °C
• 단기간 온도저항	90 °C	• 정적 전단응력 (23°C)	very good
• 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는	네	• 정적 전단응력 (40°C)	very good
• 무용제	네		



# tesa® 70665 Bond & Detach

## 제품 정보

### 접착력(수치)

• 알루미늄접착력 (초기)	15 N/cm	• PE접착력 (초기)	11 N/cm
• 알루미늄접착력 (14일 경과)	15 N/cm	• PE접착력 (14일 경과)	11 N/cm
• Magnesium 면의 접착력 (초기)	13 N/cm	• Steel접착력 (초기)	22 N/cm
• Magnesium 면의 접착력 (14일 경과)	13 N/cm	• Steel접착력 (14일 경과)	22 N/cm

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고

있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성

또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=70665>